

本技术论坛由钢泰、安世半导体及瑞能半导体担任赞助商，26家参展企业将通过本平台进行市场趋势分析、新品发布、解决方案演示和商务洽谈配对等商业活动，共同解读尖端技术及行业需求。

电力电子应用技术论坛

Power Electronics Application Forum

论坛赞助商：



IWATSU ELECTRIC CO., LTD.



使用新一代 H 系列单管 IGBT 设计高效新能源系统

10:00

-

10:20

周明，英飞凌科技零碳工业功率事业部大中华区高级工程师
英飞凌科技（中国）有限公司
Infineon Technologies China Co., Ltd.

应用于新能源领域的功率半导体模块

10:20

-

10:40

朱明远，富士电机半导体技术支持
富士电机（中国）有限公司
Fuji Electric (CHINA) Co., Ltd.

功率半导体器件在储能领域的应用和发展趋势

10:40

-

11:00

马克强，研发中心总经理
成都森未科技有限公司
Chengdu Semi-Future Technology Co.,Ltd

瑞能硅基功率二极管产品系列及其应用介绍

11:00

-

11:20

索志民，高级产品应用经理
瑞能半导体科技股份有限公司
WeEn Semiconductors Co., Ltd

SiC 功率器件特性和应用暨 AOS αSiC 技术发展

11:20

-

11:40

朱礼斯
万国半导体元件（深圳）有限公司
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS)

功率电子：产品总览、工艺和技术路线

11:40

-

12:00

赵宇，业务发展经理
麦德美爱法
MacDermid Alpha

高温无铅芯片焊接材料创新及应用

13:00

-

13:20

胡彦杰，华东区高级技术经理
钢泰公司
Indium Corporation

千瓦级氮化镓器件设计实例

13:20

-

13:40

张大江，研发总监
珠海镓未来科技有限公司
Ganext (Zhuhai) Technology Co.,Ltd

本技术论坛由钢泰、安世半导体及瑞能半导体担任赞助商，26家参展企业将通过本平台进行市场趋势分析、新品发布、解决方案演示和商务洽谈配对等商业活动，共同解读尖端技术及行业需求。

电力电子应用技术论坛

Power Electronics Application Forum

论坛赞助商：

nexperia



IWATSU ELECTRIC CO., LTD.



13:40



14:00



Condura™.ultra 无银 AMB 氮化硅基板---车规级功率模块用高性价比解决方案

张靖 贺利氏电子中国区研发总监
上海贺利氏工业技术材料有限公司
Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd.

安世半导体 IGBT 的简要介绍

14:00

张姗姗 产品市场经理
安世半导体
Nexperia

最新三菱电机 DIPIPM™介绍

14:20

王小岭
三菱电机机电（上海）有限公司
Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.

三菱电机下一代车载功率模块

14:40

赵利忠
三菱电机机电（上海）有限公司
Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.

用于 SiC/GaN 器件损耗测试的 1.5GHz 光绝缘探头、500MHz 高压差分探头

15:00

长滨 龙，担当课长
岩崎通信机株式会社
IWATSU ELECTRIC Co., Ltd.

15:20

全面评价第三代功率半导体，从静态到动态参数测试

15:20

Ji-ZE ZHANG
是德科技(中国)有限公司
Keysight Technologies (China) Co., Ltd

15:40

SKiiP7--为迎接挑战而设计

SKiiP7 – Designed to Meet the Challenges

15:40

Anastasia Schiller, 产品经理
赛米控丹佛斯
Semikron Danfoss

16:00

本技术论坛由钢泰、安世半导体及瑞能半导体担任赞助商，26家参展企业将通过本平台进行市场趋势分析、新品发布、解决方案演示和商务洽谈配对等商业活动，共同解读尖端技术及行业需求。

电力电子应用技术论坛

Power Electronics Application Forum

论坛赞助商：

nexperia



车规级 SiC 的可靠性分析与产品方案

10:00 张昌明，英飞凌科技大中华区汽车电子事业部 动力系统与新能源业务单元高级市场经理

10:20 英飞凌科技（中国）有限公司
Infineon Technologies China Co., Ltd.

10:20 高效高可靠新型封装车规级 SiC 功率模块暨赛晶车规级 HEEV 封装 SiC 模块发布

- 马先奎，市场兼技术支持总监
10:40 赛晶科技集团有限公司
Sun.King Technology Group Limited

10:40 车规级碳化硅功率半导体模块精准动静态特性与可靠性测试解决方案

- 毛赛君，总经理
11:00 忱芯科技（上海）有限公司
UniSiC

11:00 SEMITRANS20 助力未来大功率变换器

- 赵满员，产品经理
11:20 赛米控丹佛斯
Semikron Danfoss

11:20 碳化硅加速新一代光储充应用创新

- 贾鹏，应用市场工程师
11:40 安森美
Onsemi

11:40 模拟 IC 驱动能源转换效率与系统可靠性

- 庞家华，技术市场经理
12:00 纳芯微电子
Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Co., Ltd.

13:00 四代 SiC 以及模块设计的注意点

- 陆昀宏，经理
13:20 罗姆半导体（上海）有限公司
ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

本技术论坛由钢泰、安世半导体及瑞能半导体担任赞助商，26家参展企业将通过本平台进行市场趋势分析、新品发布、解决方案演示和商务洽谈配对等商业活动，共同解读尖端技术及行业需求。



SABIC 新一代应用于 DC-LINK 电容器的耐高温薄膜 ELCRES™ HTV150A

13:20

-

周渊，副高级研究员 Lead Scientist

13:40

沙特基础工业公司
SABIC

TOLL 封装在新能源的应用

13:40

-

张涛峰，技术总监

14:00

深圳市思开半导体有限公司
SHENZHEN SKY SEMICONDUCTOR LIMITED

面向轨道交通和输能应用且具有遥测功能的门极驱动器

14:00

-

李组精，门极驱动部门系统工程师

14:20

Power Integrations

富士车规级 IGBT 产品介绍

14:20

-

陈磊，技术支持工程师

14:40

富士电机（中国）有限公司
Fuji Electric (CHINA) Co., Ltd.

新型功率器件在光伏储能领域的应用与发展

14:40

-

荣睿，市场总监

15:00

江苏宏微科技股份有限公司
MacMic Science & Technology Co., Ltd

针对服务器的高功率密度电源解决方案

15:00

-

胡立松，英飞凌科技电源与传感系统事业部大中华区 数据中心和计算应用中心
高级首席工程师

15:20

英飞凌科技（中国）有限公司
Infineon Technologies China Co., Ltd.

如何为高压电动汽车挑选安全可靠的元器件？

15:20

-

Faith Luo, Staff Application Engineer

15:40

楼世电子（上海）有限公司
Knowles Precision Devices

化合物半导体助力高精度电流传感

15:40

-

朱忻

16:00

苏州矩阵光电有限公司
Matrix Opto.CO.,Ltd